

2015-2020年中国引线框架 市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国引线框架市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/jiancai1502/167198NE9U.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2015-02-10

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国引线框架市场分析与投资前景研究报告》共十二章。报告是博思数据的研究成果，通过文字、图表向您详尽描述您所处的行业形势，为您提供详尽的内容。博思数据在其多年的行业研究经验基础上建立起了完善的产业研究体系，一整套的产业研究方法一直在业内处于领先地位。引线框架行业研究报告是2014-2015年度，目前国内最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的研究报告产品，为您的投资带来极大的参考价值。

目前，国际集成电路封装技术以BGA、CSP为主流技术，而国内厂商则仍然以DIP、SOP、QFP为主，产品以中、低端为主，发达国家在技术水平上占有优势。我国下游封装测试企业的技术水平决定了我国封装材料产品结构。目前我国引线框架产品主要以TO、DIP等低脚数产品为主，高端引线框架产品无法自主生产或者无法进入高端封装测试企业的供应商行列。我国半导体行业的壁垒主要是技术壁垒，要在高端封装如BGA、CSP、SIP等框架设计与制造上赶超国际先进水平，在技术、人才上有一定的困难。

我国引线框架行业与国外的差距

我国半导体封装业整体水平和全球主流技术还存在一定的差距，主要集成电路封装技术还处于表面贴装阶段水平，国内本土集成电路封装测试企业主要采用的封装形式是DIP、SOP、PLCC以及QFP等传统技术，产品大都属于中低档类，附加值较高的BGA、FC、CSP等高尖封装技术目前还未完全掌握，而外资封装测试厂已经实现在全球生产资源配置，多采用主流BGA、CSP、MCM、MEMS等封装形式，技术水平高于国内本土企业。

随着中高档封装形式（SSOP、TSOP、QFP、TQFP、PBGA等）市场需求不断增长，引线框架的设计不断向多排、MTX、小基岛、IDF方向发展，电镀朝着宽排、环镀方向发展。目前国内主要供应70×250mm框架，而国外厂商主要适用的框架片宽片长都是78×250mm以上，以后会朝着90×290mm更大的片宽设计。冲压朝着深打凸、引线小间距方向发展，目前国内供应的框架引脚间距在3.9mil，引脚宽在4.3mil，而国外厂商要求引脚间距最小3.6mil，引脚宽最小3.8mil。高档引线框架目前依然依赖于进口，特别是细间距、多引脚产品。

为了提升我国半导体产品结构，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中将“大规模集成电路制造技术及成套工艺”确定为16个重大专项之一。

国内引线框架生产企业起步较早，多年来引线框架企业为国内IC和分立器件生产配套，具有产品研制、开发和大生产能力，一直担当引线框架生产的主力军，但国内的引线框架产量

仅能满足50%左右的国内需求，大部分高端产品还需要进口，且大多数是引线少，节距大的一般产品，满足不了国内市场的需求。

2013年我国引线框架行业市场规模达到了92.2亿元，同比2012年的80亿元增长了15.25%，2014年我国引线框架行业市场规模约106.6亿元。近几年我国引线框架行业市场规模情况如下图所示：2007-2014年我国引线框架行业市场规模 数据来源：中国半导体行业协会 博思数据整理

2014年中国引线框架行业细分产品市场规模（亿元）	2014年市场规模（亿元）	分立器件用引线框架	2013年市场规模（亿元）
65.0	集成电路用引线框架	35.0	57.2
		41.6	

数据来源：博思数据整理

报告目录：第一章 2013-2014年中国引线框架行业发展环境分析1

第一节 中国经济环境分析1

一、2013年宏观经济运行情况1

二、2009-2013年中国居民（消费者）收入情况3

三、2009-2013年中国城市化率4

四、2015年中国经济发展预测分析5

第二节 引线框架行业相关政策6

一、国家“十二五”产业政策6

二、其他相关政策（标准、技术）6

三、出口关税及相关税收政策8

第三节 中国引线框架行业发展社会环境分析9

一、人口环境分析9

二、教育环境分析10

三、文化环境分析12

四、生态环境分析14

五、中国城镇化率16

六、居民的各种消费观念和习惯16 第二章 2013年全球引线框架行业发展分析23

第一节 2013年全球引线框架行业发展现状23 1、全球半导体产业发展现状分析

据美国半导体行业协会统计数据：2013年12月，全球半导体产业销售额为266.5亿美元，较上年同期的247.4亿美元增长7.7%；2013年1-12月全球半导体产业销售额达到3055.8亿美元，同比增长4.8%。2007-2013年全球半导体产业销售额 资料来源：美国半导体行业协会 2013年12月美洲半导体产业销售额度为58亿美元，同比增长17.3%，环比下降1.3%；欧洲市场销售额为29.6亿美元，同比增幅为12.7%，环比下降3.9%；日本市场销售额为29.3亿美元，同比下滑8.2%；环比下降为4.8%。2013年12月全球半导体产业销售额区域分布格局（十亿美金）

市场	2013年11月	2013年12月	环比增长	美洲	5.87
5.80	-1.3%	欧洲	3.08	2.96	-3.9%
3.07	2.93	-4.8%	亚太	15.16	14.96
合计	27.19	26.65	-2.0%	市场	2013年11月
月	同比增长	美洲	4.94	5.80	17.3%
2.63	2.96	12.7%	日本	3.19	2.93
亚太	13.98	14.96	7.1%	合计	24.74
	市场	2012年	2013年	年度数据	美洲
61.50	13.1%	欧洲	33.16	34.88	5.2%
41.06	34.80	-15.2%	亚太	162.98	174.41
合计	291.56	305.58	4.8%	资料来源：博思数据整理	2、全球半导

体引线框架产业现状

引线框架、金丝均属于半导体/微电子封装专用材料，在半导体封装过程起着重要的作用。微电子或半导体封装，直观上就是将生产出来的芯片封装起来，为芯片的正常工作提供能量、控制信号，并提供散热及保护功能。

狭义的封装是指：利用膜技术及微细连接技术，将半导体元器件及其他构成要素在框架或基板上布置、固定及连接，引出接线端子，并通过可塑性绝缘介质灌封固定，构成整体立体结构的工艺。

引线框架是一种用来作为集成电路芯片载体，并借助于键合丝使芯片内部电路引出端（键合点）通过内引线实现与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件。在半导体中，引线框架主要起稳固芯片、传导信号、传输热量的作用，需要在强度、弯曲、导电性、导热性、耐热性、热匹配、耐腐蚀、步进性、共面形、应力释放等方面达到较高的标准。

据统计：2013年全球引线框架需求量达到5460亿个，较2012年同期增长6.5%，行业市场规模为33.42亿美元，较2012年同期下滑3.7%。产品均价下降是导致引线框架产品销量与市场规模出现背离走势的主要因素。2004-2013年全球引线框架产品价格走势

资料来源：博思数据整理 第二节 2013年全球引线框架行业主要品牌25

一、全球引线框架行业主要品牌25 目前半导体封装材料行业被日本企业主导，全球半导体封装材料销售额中，超过60%的销售收入来源于日本企业（含日本企业在其他国家投资的企业）；韩国企业也通过出口逐步扩大其市场份额。全球知名的封装材料供应商

封装材料	供应商名称	引线框架	日本住友金属矿业公司
	日本三井高科技股份公司	日本日立电线有限公司	日本新光电气
工业公司	有机载板	日本揖斐电公司	日本新光电气工业公司

台湾南亚电路板股份有限公司
有限公司

德国贺利氏集团公司

键合丝 日本田中贵金属工业
日本住友金属矿业公司

日本日铁微金属有限公司

资料来源：博思数据整理

目前中国从事引线框架生产

的企业较少，整体技术水平也低于国外同行业生产企业，产品多以分立器件用引线框架为主，集成电路用引线框架所占比率相对较低。在国际上，日本住友、日本三井高科技、荷兰柏狮电子、荷兰先进半导体等行业地位显著的公司纷纷在中国设立子公司生产中低档的引线框架产品，以降低产品成本。二、全球引线框架行业主要品牌市场占有率格局26

第三节 2013年全球引线框架行业供求情况27

一、2009-2013年全球引线框架行业产量情况27

二、2009-2013年全球引线框架行业需求情况28

三、2009-2013年全球引线框架行业市场规模29

第四节 2014-2020年全球引线框架行业供求预测30

第五节 2014-2020年全球引线框架行业市场规模预测39 第三章 引线框架行业概述40

第一节 引线框架定义及分类40 引线框架是一种用来作为集成电路芯片的金属结构载体。引线框架是借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气电路的关键结构件。引线框架是电子信息产业中重要的IC封装材料。引线框架产品实例

资料来源：博思数据整理 引线框架的主要功能是为芯片提供机械支撑的载体，并作为导电介质内外连接芯片电路而形成电信号通路，以及与封装外壳一同向外散发芯片工作时产生热量的散热通路。

引线框架作为一种框架材料，在半导体封装中充当着电路连接、封装内部散热、芯片机械支撑等重要作用。虽然目前有着多种的封装形式,但无论是金属封装,还是陶瓷封装、塑料封装等都离不开引线框架。引线框架在半导体封装中的应用及位置

资料来源：博思数据整理 引线框架根据应用于不同的半导体，可以分为应用于集成电路的引线框架和应用于分立器件的引线框架两大类。这两大类半导体所采用的后继封装方式各不相同，种类繁多。不同的封装方式就需要不同的引线框架，因此，通常以半导体的封装方式来对引线框架进行命名。集成电路运用广泛且发展迅速，目前有DIP、SOP、QFP、BGA、CSP等多种封装方式；分立器件主要是各种晶体管，封装上大都采用TO、SOT这两种封装方式。第二节 引线框架行业发展历程41

第三节 引线框架生命周期43

第四节 引线框架产业链分析44

一、产业链模型介绍44

二、引线框架产业链模型分析47

第五节 引线框架上游行业分析48

一、上游行业概述48

二、上游行业发展现状48

第六节 引线框架下游行业分析49

一、下游行业概述49

二、下游行业发展现状50

第七节 上下游行业对引线框架行业的影响分析61 第四章 中国引线框架行业技术及产品发展竞争情况分析62

第一节 国内外引线框架行业技术发展现状62

第二节 引线框架行业技术流程或发展特点分析63

第三节 引线框架行业技术发展趋势64

第四节 引线框架行业产品价格分析64

第五节 引线框架产业技术竞争分析65

第六节 引线框架产业最新动态分析66

第七节 引线框架行业市场项目情况69 第五章 中国引线框架行业市场现状及预测分析76

第一节 2009-2014年中国引线框架行业市场规模76 2013年我国引线框架行业市场规模达到了92.2亿元，同比2012年的80亿元增长了15.25%，2014年我国引线框架行业市场规模约106.6亿元。近几年我国引线框架行业市场规模情况如下图所示：2007-2014年我国引线框架行业市场规模 数据来源：中国半导体行业协会 博思数据整理 2014年中国引线框架行业细分产品市场规模

规模	细分产品	2013年市场规模（亿元）		2014年市场规模（亿元）
35.0	分立器件用引线框架	57.2	65.0	集成电路用引线框架
41.6				

35.0 41.6 数据来源：博思数据整理 第二节 2009-2014年中国引线框架行业产量分析77

第三节 2009-2014年中国引线框架行业市场需求情况78

第四节 2009-2014年中国引线框架行业进出口情况78

第五节 2014-2020年中国引线框架产业投资环境分析79

第六节 2014-2020年中国引线框架产业投资机会分析88

一、引线框架行业市场产量预测88

二、引线框架行业市场需求预测88

三、引线框架行业市场规模预测89

第七节 2014-2020年中国引线框架产业进出口预测89 第六章 2013-2014年中国引线框架产业市

市场竞争格局分析90

第一节 2013-2014年中国引线框架产业竞争现状分析90

一、引线框架市场竞争情况分析90

二、引线框架行业SWOT分析91

第二节 2013-2014年中国引线框架行业集中度分析93

一、市场集中度分析93

二、企业区域分布集中度93

三、行业市场消费区域集中度94

第三节 我国引线框架行业外资进入情况94

第四节 我国引线框架行业合作和并购情况94 第七章 2011-2013年中国引线框架所属行业主要数据监测分析96

第一节 2011-2013年中国引线框架所属行业总体数据分析96

一、2011年中国引线框架所属行业全部企业数据分析96

二、2012年中国引线框架所属行业全部企业数据分析98

三、2013年中国引线框架所属行业全部企业数据分析99

第二节 2011-2013年中国引线框架所属行业不同规模企业数据分析101

一、2011年中国引线框架所属行业不同规模企业数据分析101

二、2012年中国引线框架所属行业不同规模企业数据分析101

三、2013年中国引线框架所属行业不同规模企业数据分析102

第三节 2011-2013年中国引线框架所属行业不同所有制企业数据分析102

一、2011年中国引线框架所属行业不同所有制企业数据分析102

二、2012年中国引线框架所属行业不同所有制企业数据分析103

三、2013年中国引线框架所属行业不同所有制企业数据分析103 第八章 2013-2014年中国引线框架行业重点厂商分析105

第一节 宁波康强电子股份有限公司105

一、企业概况105

二、企业经营及相关财务指标106

第二节 深圳赛格高技术投资股份有限公司 (SHIC) 110

一、企业概况110

二、企业经营及相关财务指标111

第三节 广州丰江微电子有限公司114

一、企业概况114

二、企业经营及相关财务指标	115
第四节 中山复盛机电有限公司	116
一、企业概况	116
二、企业经营及相关财务指标	117
第五节 成都住矿电子有限公司	119
一、企业概况	119
二、企业经营及相关财务指标	119
第九章 中国引线框架行业竞争情况	121
第一节 引线框架行业进入壁垒 / 退出机制	121
第二节 行业竞争结构分析	122
一、现有企业间竞争	122
二、潜在进入者分析	122
三、替代品威胁分析	123
四、供应商议价能力	123
五、客户议价能力	124
第三节 行业国际竞争力比较	124
第十章 2014-2020年中国引线框架产业投资风险分析	126
第一节 2014-2020年中国引线框架产业投资风险分析	126
一、市场运营风险	126
二、技术风险	126
三、政策风险	127
四、进入退出风险	127
第二节 产品定位策略	128
一、市场细分策略	128
二、目标市场的选择	128
第三节 产品开发策略	128
一、销售模式分类	128
二、市场投资建议	129
第四节 品牌经营策略	130
一、不同品牌经营模式	130
二、如何切入开拓品牌	131
第五节 服务策略	132
第十一章 博思数据关于引线框架行业投资机会分析研究	133
第一节 2014-2020年引线框架行业主要区域投资机会	133
第二节 2014-2020年引线框架行业出口市场投资机会	134

第三节 2014-2020年引线框架行业企业的多元化投资机会135

第四节 中国引线框架产品原材料投资机会分析136

一、我国引线框架产品主要原材料价格情况136

二、我国引线框架产品主要原材料价格走势预测137 第十二章 2014-2020年中国引线框架行业发展策略及投资建议141

第一节 引线框架行业发展策略分析141

一、坚持产品创新的领先战略141

二、坚持品牌建设的引导战略141

三、坚持工艺技术创新的支持战略141

四、坚持市场营销创新的决胜战略142

五、坚持企业管理创新的保证战略142

第二节 引线框架行业市场的关键客户战略实施142

一、实施关键客户战略的必要性142

二、合理确立关键客户143

三、对关键客户的营销策略144

四、强化关键客户的管理144

五、实施关键客户战略要重点解决的问题145

第三节 投资建议147

一、重点投资区域建议147

二、重点投资产品建议148 本研究咨询报告由博思数据领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、知识产权局、博思数据提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

报告揭示了引线框架行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国引线框架做了重点企业经营状况分析，并分析了中国引线框架行业发展前景预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jiancai1502/167198NE9U.html>